

熱源より発生した熱を最大限に水平方向(面方向)へ移動・拡散させた後、  
 垂直方向(厚み方向)に熱伝導させるシートです。機器内の熱の安定性に貢献します。  
**驚異の熱伝導率 200W/m・K(面方向)**

高放熱性

# “ 熱 拡 散 シ ー ト ”

## 【特徴】

- 熱源にシートを貼り、熱を逃がしたい放熱体・筐体に密着させ使用します。(熱源と放熱体・筐体の間に挟んで使用します。)
- IT機器内のヒートスポットを緩和し、機器内の熱を安定させることができます。
- グラファイトシートに比べ、柔軟性があり、作業性に優れています。
- 構造は、セラミックスと複合金属層ですので、手を汚さず作業できます。
- 使用用途、場所に応じた形状にカットし、使用できます。
- ヒートスプレッダとして使用でき、効果を発揮できます。
- 表面のみ絶縁性です。(断面は絶縁性ではありません)
- グラファイトシートに比べ、低コストです。
- RoHS指令準拠。

## ～製品の豆知識～

熱拡散シートとは・・・簡単に言いますと、例えばシートの端に熱源(Hot spot)を設置した場合、その熱を反対方向の端に速やかに熱移動させるシートです。熱源(Hot spot)を中央に設置した場合は、シート上に熱拡散します。一ヶ所に熱をこもらせずに熱移動・熱拡散させることがポイントです。その結果、熱源(Hot spot)の温度を速やかに下げることができます。

## 【用途】

- スマートフォン、携帯電話、携帯ゲーム機等の小型電子機器。
- ノートPC、LED、プロジェクター、車載機器等のIT機器等。
- CPU、MPU等の発熱体に。

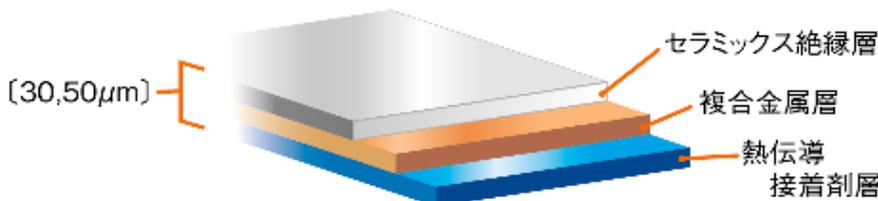
(表面)



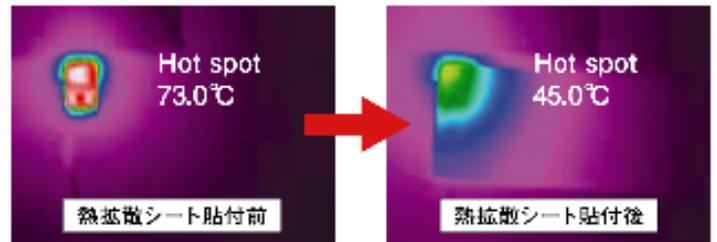
(裏面)



(構造)



## 【熱拡散効果】



型番	TS03-145	JAN: 4524945011090
寸法	95mm × 145mm × 厚さ0.03mm	
熱伝導率	200W/m・K 面方向 (厚み方向1.5W/m・K)	
体積抵抗率	10 <sup>10</sup> Ω・cm セラミックス面	
粘着力	7 N/25mm (片面粘着)	
使用温度範囲	-20°C ~ 120°C	比重: 4.8g/cc

型番	TS03-95	JAN: 4524945011106
寸法	95mm × 95mm × 厚さ0.03mm	
熱伝導率	200W/m・K 面方向 (厚み方向1.5W/m・K)	
体積抵抗率	10 <sup>10</sup> Ω・cm セラミックス層	
粘着力	7 N/25mm (片面粘着)	
使用温度範囲	-20°C ~ 120°C	比重: 4.8g/cc

型番	TS05-145	JAN: 4524945011113
寸法	95mm × 145mm × 厚さ0.05mm	
熱伝導率	200W/m・K 面方向 (厚み方向2.0W/m・K)	
体積抵抗率	10 <sup>10</sup> Ω・cm セラミックス面	
粘着力	7 N/25mm (片面粘着)	
使用温度範囲	-20°C ~ 120°C	比重: 5.8g/cc

型番	TS05-95	JAN: 4524945011120
寸法	95mm × 95mm × 厚さ0.05mm	
熱伝導率	200W/m・K 面方向 (厚み方向2.0W/m・K)	
体積抵抗率	10 <sup>10</sup> Ω・cm セラミックス面	
粘着力	7 N/25mm (片面粘着)	
使用温度範囲	-20°C ~ 120°C	比重: 5.8g/cc

【お問合せ先】  
 株式会社ワイドワーク  
 TEL: 03-5818-7532  
 FAX: 03-5818-7533  
 mail: satoh@widework.co.jp